



Кваліфікація магістр з мікро- та наносистемної техніки за освітньо-професійною програмою мікроелектронні інформаційні системи

Строк навчання на базі 1 р. 5 м. перший бакалаврський рівень ОКР спеціаліст

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

магістра з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування"

153 "Мікро- та наносистемна техніка"

Мікроелектронні інформаційні системи

денна

2017

1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

курс	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень
1	1 2 3 4	5 6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52
2	п п п п	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д	д д д д

Позначення: З Заняття С Сесія П Практика ЗТ Заліковий тиждень ПК Проміжний контроль Курсовий проект (робота) ЗД Підсумкова атестація

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ ЧАСУ (В ТИЖНЯХ)

курс	Заняття	Проміжний контроль	Заліковий тиждень	Екзамени, сесія	Практика	Виконання дипломного проекту	Канікули	Разом
1 курс	24	2	2	6			18	52
2 курс					4	16		20
Всього	24	2	2	6	4	16	18	72

ПРАКТИКА

Назва практики	Семестр	Тижні
Переддипломна практика	3	4

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Форма	Семестр
Кваліфікаційна робота із захистом у ЕК	3

2. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

№ п/п	Шифр за опп	Назва навчальної компоненти	Розподіл за семестрами				Кількість кредитів ECTS	Загальний обсяг	Кількість годин					Розподіл годин			
			Екзамени	Заліки	Курсові проекти	роботи			Аудиторні					1 курс		2 курс	
1	2	3	4	5	5	6	8	9	9	10	лабора торні	практич ні	Самостійна робота	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр
14																	
15																	
16																	
17																	
1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ																	
1.1 Цикл загальної підготовки																	
1	Іноземна мова за професійним спрямуванням			1,2			4	120	48			48	72	24	24		
Разом						4	120	48			48	72	24	24			
1.2 Цикл професійної підготовки																	
2	Методи дослідження матеріалів та компонентів мікро- та нанoeлектронної техніки		1				4	120	36	24	12		84	36			
3	Охорона праці в галузі та цивільний захист			2			3	90	36	24		12	54		36		
4	Напівпровідникові квантові структури та надгратки		1				4	120	36	12	24		84	36			
Разом						11	330	108	60	36	12	222	72	36			
1.3 Практична підготовка																	
5	Переддипломна практика			Зд			6	180					180			*	
Разом						6	180					180					
1.4 Підсумкова атестація																	
6	Підготовка кваліфікаційної роботи						22,5	675					675			*	
7	Підсумкова атестація						1,5	45					45			*	
Разом							24	720					720				
Разом з обов'язкових компонент							45	1350	156	60	36	60	1194	96	60		
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ																	
2.1 Цикл загальної підготовки																	
2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу																	
8	Інтелектуальна власність			2			1	30	12	12			18		12		
9	Філософські проблеми наукового пізнання			2			1	30	12	12			18		12		
Разом						2	60	24	24				36		24		
2.2 Цикл професійної підготовки																	
2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу																	
10	Надшвидкодійні прилади мікро- та нанoeлектроніки		2				2	60	12	12			48		12		
11	Курсова науково-дослідна робота			1		2	16	480					480		*		
Разом							18	540	12	12			528		12		
2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір																	
12	Конструювання та технологія фотоелектричних перетворювачів		2		2		4	120	24	12	12		96		24		
		Діагностика, контроль та випробування мікроелектронних пристроїв															
13	Субмікронні технології		1				4	120	36	24	12		84	36			
		Засоби захисту інформації в мережах електронно-обчислювальних машин															
14	Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах		1				4	120	36	24	12		84	36			
		Лазерна техніка та технології															
15	Елементна база мікроелектронної апаратури			1			4	120	48	24	24		72	48			
		Експертні системи															
Разом							16	480	144	84	60		336	120	24		
2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента																	
16	Мікроелектронні давачі та перетворювачі		2				5	150	48	24	24		102		48		
		Поверхневі та контактні явища напівпровідникових структур															
17	Мікроелектронні пристрої			2			4	120	48	24	24		72		48		
		Фізичні основи надійності мікроелектронних інформаційних систем															
Разом							9	270	96	48	48		174		96		
Разом з вибіркових компонент							45	1350	276	168	108		1074	120	156		
Разом з циклу компонент загальної підготовки							6	180	72	24		48	108	24	48		
Разом з циклу компонент професійної підготовки							54	1620	360	204	144	12	1260	192	168		
РАЗОМ							90	2700	432	228	144	60	2268	216	216		
Кількість аудиторних годин на тиждень														18	18		
Загальна кількість кредитів														30	30	30	
Кількість екзаменів														4	3		
Кількість заліків														3	5	1	
Кількість курсових робіт															1		
Кількість курсових проектів															1		

Перший проректор В.А. Воденніков

Проректор з НРП Г.П. Коломоєць

Начальник НВ С.М. Кісельов

Декан ФЕЕП

В.Л. Коваленко

Завідувач кафедри МЕІС

Ю.С. Оселечник